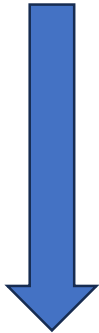


HSQ-180	Nama Dokumen	Approved	Checked	Prepared
	レーザプログラム管理要領書			

- 1, 適用範囲
- 1 HKI社内におけるレーザー加工工程に使用するプログラムの管理に対し適応する。
- 2, 目的
- 1 誤製品の作成を防止する為。
- 2 異材使用による不具合を起こさないことを目的とする。
- 3, 要領
- 1

加工指示書（KPK）より、部品品番（プログラム番号）・指示数量、及び材質・板厚が作業者へ指示される。



レーザーのフォルダから対象のプログラムを選び、切断データを呼び出す。



対応する材料をセットし、切断。

1 of 2

ADDITIONAL

KARTU PERINTAH KERJA

DueDate MPP :07-Jan-25

ADD-20241226

Item Code

56B045211114

1

PLATE

Process :LASER

NCT : 0Laser :

Material : SS400P-4.5X22X679 => 1 Pcs

Material Size : SS400P-4.5X22X679

Proc. Time : MasterQty [in Minute]

SHP : =>

NCT : =>

BP : =>

0.00

SHP

NCT

BP

PLASMA

LASER

PRESS

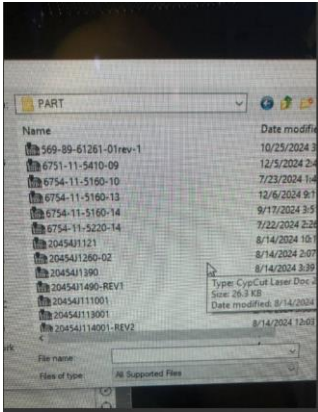
ROLL

LOCATION :

Diterima PC :

SS400P: t4.5x679x22

Print Date : 12/26/2024 7:25:24 PM



Dibuat	2025, 1	Alasan :	Revisi 3.	Alasan :
Revisi 1.		Alasan :	Revisi 4.	Alasan :
Revisi 2.		Alasan :	Revisi 5.	Alasan :